

## △注意・使用上の注意

### ■使用上の注意（保管・使用環境）

1. 温度-10℃～40℃、湿度30～85%で保管してください。
  2. 硫黄や塩素を含まない雰囲気でご保管してください。
  3. 製品納入後、6ヶ月以内にご使用ください。
  4. 最小梱包単位は、使用直前まで開封しないでください。
  5. 直射日光の当たる所での保管は、避けてください。
  6. 当製品は以下の環境および条件ではご使用頂けません。  
当製品を下記環境および条件で使用される場合には、あらかじめ当社までご連絡ください。
- (1) 腐食性ガス雰囲気（塩素ガス、硫化水素ガス、アンモニアガス、亜硫酸ガス、酸化窒素ガス）
  - (2) 液体中（水、油、薬液、有機溶剤等）
  - (3) 塵埃の多い所
  - (4) 直射日光の当たる所
  - (5) 静電気や電界強度の影響が強い所
  - (6) 潮風の強い所
  - (7) その他(1)～(6)項に準ずる所

### ■使用上の注意（定格上の注意）

1. 製品をレオスタット（部分負荷）でご使用の場合、定格電力は抵抗値の割合に比例して軽減してください。
2. 最大印加電圧は $\sqrt{P \cdot R}$ または最高使用電圧のいずれか小さい方を超えないでください。

### ■使用上の注意（実装上の注意）

1. はんだ付け
  - (1) リフローおよびはんだコテによるはんだ付けが可能です。フローはんだ付けはできません。フローはんだ付けをしますと、製品の機能が損なわれます。
  - (2) 当社の標準ランド寸法にて使用してください。必要以上に大きすぎる場合、はんだ熔融時の表面張力により位置ずれ発生の原因となります。また、逆に小さすぎるとはんだ付け強度不足となります。
  - (3) 標準はんだ付条件  
温度プロファイルをご覧ください。はんだ付け時間が長すぎたり、はんだ付け温度が高すぎたりしますと、製品の機能を損なう恐れがあります。
  - (4) はんだ量が過少・過多にならないようにして、はんだ付けをしてください。なお、リフローはんだの場合、クリームはんだの塗布厚は100～150 $\mu$ mとし、ランドパターンは当社標準寸法を厳守してください。過少の場合は、はんだ固着強度不足の原因となります。過多の場合は、はんだブリッジの原因となります。
2. 実装
  - (1) トリマポテンショメータを基板に取り付ける際、トリマポテンショメータに4.9N（参考値：500gf）以上の力を加えないようにしてください。
  - (2) 基板に大きなソリや曲げを加えた場合トリマポテンショメータが破損する場合がありますので、基板のソリ、曲がりを防止する取り扱いをしてください。
  - (3) プレーサーのノズル寸法は、外径1.5～1.8mm、内径1.3mm程度を推奨します。
3. 洗浄
  - (1) フラックスが摺動面上に付着した場合は、洗浄によりフラックスを完全に除去してください。
  - (2) 洗浄溶剤は、イソプロピルアルコール・エチルアルコールが使用可能です。上記以外の溶剤をご使用になる場合は、実機評価にて十分な性能確認を実施してください。

### ■使用上の注意（取り扱い上の注意）

1. ドライバー溝に合った調整用ドライバーをご使用ください。下記ドライバーを推奨いたします。  
・手調整用推奨ドライバー：KMDR190
2. 調整ドライバーは製品に対して垂直に挿入し、ドライバープレートへのドライバーによる加圧は、許容値4.9N（参考値：500gf）以下にしてください。許容値以上の圧力を加えた場合、製品を破損したり、機能を損なう恐れがあります。
3. 電気的有效回転角度内でご使用ください。当製品は、回転止めがありませんので、電気的有效回転角度を超えてドライバープレートを回転させた場合、製品の機能を損なう恐れがあります。
4. ロックペイントを用いて調整位置を固定されたり、製品全体を樹脂コーティングされる場合は、実機評価にて十分な性能確認を実施してください。これを怠ると腐食、接触不良の原因となる恐れがあります。

### ■使用上の注意（その他）

1. 当製品のご使用にあたっては、実際の貴社製品に実装した状態で必ず評価・確認してください。
2. 当カタログの記載内容を逸脱して当製品を使用されたことよって生じた不具合につきましては、当社は保証致しかねますのでご了承ください。